

- [01] Bosch legt Grundstein für Chipfabrik der Zukunft**
- [02] Grundsteinlegung 300-Millimeter-Halbleiterwerk Dresden**
- [03] Halbleiterfertigung bei Bosch**
- [04] Deutschland kann Hightech: Halbleiter sind der Grundstein für mehr Lebensqualität**
- [05] Dr.-Ing. Dirk Hoheisel**
- [06] Bosch beginnt mit Bau seiner neuen Halbleiterfabrik**
- [07] Schlüsseltechnologie für das Internet der Dinge: Bosch errichtet neues Halbleiterwerk in Dresden**
- [08] Neue Halbleiter-Fertigung von Bosch in Dresden**
- [09] Schlüsseltechnologie für die Automobiltechnik und das Internet der Dinge: Bosch errichtet neues Halbleiterwerk in Dresden**

Robert Bosch GmbH
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart

Media und Public Relations
Leitung: René Ziegler
Presse-Forum:
www.bosch-presse.de



Bosch legt Grundstein für Chipfabrik der Zukunft Stärkung des Hochtechnologiestandorts Deutschland

25. Juni 2018

PI 10669 RB Ka/af

- ▶ Schlüsseltechnologie: Halbleiter für Automobiltechnik und Internet der Dinge
- ▶ Ausbau der Fertigungskapazitäten: Immer mehr Chip-Anwendungen
- ▶ Milliardeninvestition: High-Tech-Werk mit 700 Arbeitsplätzen
- ▶ Künstliche Intelligenz: Qualitätssicherung durch vernetzte Fertigung
- ▶ Bosch-Geschäftsführer Hoheisel: „Halbleiter sind der Grundstein für mehr Lebensqualität.“
- ▶ Bundes- und Landespolitik betonen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands

Stuttgart/Dresden – Mit der Grundsteinlegung in Dresden erreicht der Bau der modernsten Halbleiterfabrik der Bosch-Gruppe einen wichtigen Meilenstein: Bereits Ende 2019 soll der Komplex fertig sein, um mit dem Einzug der Fertigungsmaschinen zu beginnen. „Wir legen heute den Grundstein für die Halbleiterfabrik der Zukunft und damit auch für mehr Lebensqualität der Menschen und deren Sicherheit im Straßenverkehr“, sagte Dr. Dirk Hoheisel, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, anlässlich des Festaktes. „Halbleiter sind die Schlüsseltechnologie für das Internet der Dinge und die Mobilität der Zukunft. In Steuergeräten von Autos eingesetzt, ermöglichen sie zum Beispiel automatisiertes, ressourcenschonendes Fahren sowie bestmöglichen Insassenschutz.“ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betonte in seiner Ansprache die zentrale Bedeutung der Investition von Bosch: „Die heutige Grundsteinlegung ist ein wichtiger Beitrag für die Sicherung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Wir haben in Deutschland und Europa eine sehr gute Forschungslandschaft, aber wir dürfen hier nicht stehen bleiben, sondern wir brauchen auch die Entwicklungskompetenz, das Know-how, aber vor allem auch die industrielle Herstellung und Anwendung von Mikroelektronik in Deutschland und Europa. Daher ist die heutige Grundsteinlegung ein wichtiger Schritt.“ Das Technologie- und

Dienstleistungsunternehmen wird rund eine Milliarde Euro in seinen neuen Standort in der sächsischen Landeshauptstadt investieren. Die ersten Mitarbeiter sollen im Frühjahr 2020 ihre Arbeit im neuen Werk aufnehmen.

In Dresden errichtet die Bosch-Gruppe nach Reutlingen ihr zweites Halbleiterwerk in Deutschland. Das Unternehmen will damit seine Fertigungskapazitäten erweitern, um seine weltweite Wettbewerbsposition zu stärken. Halbleiter finden immer mehr Einsatz in den wachsenden Anwendungen im Internet der Dinge und für Mobilitätslösungen. Laut der Marktforschung Gartner ist der weltweite Halbleiterumsatz allein im Jahr 2017 um rund 22 Prozent gestiegen. „Wir liegen mit dem Bau voll im Zeitplan“, sagte der zukünftige Werkleiter Otto Graf. „In der Bauphase werden rund 7 500 Lkw-Ladungen Erde bewegt, etwa 80 Kilometer Rohrleitungen verlegt und mehr als 65 000 Kubikmeter Beton verarbeitet – das entspricht der Ladung von 8 000 Betonmischern.“ Die Pilotproduktion soll nach einer Anlaufphase voraussichtlich Ende 2021 beginnen. Dazu entsteht auf dem rund 100 000 Quadratmeter großen Grundstück – etwa so groß wie 14 Fußballfelder – ein mehrstöckiges Gebäude aus Büro- und Produktionsbereichen mit einer Gesamtnutzfläche von fast 72 000 Quadratmetern. Bis zu 700 Beschäftigte werden für die hochautomatisierte Chipfertigung tätig sein, um die Produktion zu planen, zu steuern und zu überwachen. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Produktionsprozesse sowie die Auswertung der Herstellungsdaten im weltweiten Fertigungsverbund.

Wirtschaftsstandort Sachsen: Motor für die Mikroelektronik Europas

„Die Entscheidung von Bosch markiert einen wichtigen Meilenstein. Der Bau der neuen Halbleiterfabrik hier bei uns schafft viele weitere attraktive Arbeitsplätze, stärkt den Technologie- und Wirtschaftsstandort Sachsen und ist auch gut für Deutschland und ganz Europa. Denn das Vorhaben trägt entscheidend mit dazu bei, dass die gesamte europäische Industrie auch künftig bei Zukunftstechnologien ganz weit vorne mitspielt“, erklärte der Ministerpräsident des Freistaats Sachsen Michael Kretschmer. „Die Investition in dieses Großprojekt spricht für das Vertrauen in den Freistaat Sachsen, es spricht für die Menschen, für das aufgebaute Netzwerk von Forschung und Wirtschaft und die hier vorhandene Innovationskraft.“ Bosch hat sich nach einem weltweiten Städtevergleich für den neuen Standort entschieden. „Die Landeshauptstadt besitzt ein ausgezeichnetes Mikroelektronik-Cluster“, betonte Hoheisel. Dresden zeichne sich durch eine gute Infrastruktur mit kurzen Wegen und guten Anbindungen aus. Es umfasst Unternehmen der Zulieferer-, Dienstleister- und Anwenderindustrie sowie

Universitäten mit entsprechender technologischer Expertise. Hoheisel bekräftigte: „In enger Kooperation mit Halbleiterunternehmen und Hochschulen wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Halbleitertechnologie nicht nur in Deutschland, sondern europaweit stärken.“

Halbleitertechnik: Schlüsseltechnologie für das Internet der Dinge

Basis für die Fertigung von Halbleiter-Chips aller Art ist eine Siliziumscheibe, der so genannte Wafer. Je größer sein Durchmesser, desto mehr Chips können pro Fertigungsdurchgang hergestellt werden. Unter anderem deshalb steigt Bosch mit seinem neuen Werk erstmals in die 300-Millimeter-Fertigungstechnologie ein. Mit der 300-Millimeter-Technologie lassen sich im Vergleich zur etablierten Fertigung mit kleineren 150- und 200-Millimeter-Wafern höhere Skaleneffekte erzielen. Halbleiter sind kleinste integrierte Schaltkreise mit Strukturen in Bruchteilen eines Mikrometers. Ihre mehrwöchige Herstellung ist komplex und besteht aus mehreren hundert Einzelschritten. Die Fertigung findet unter Reinraumbedingungen hochautomatisiert statt, weil bereits kleinste Partikel in der Umgebungsluft die winzigen Schaltungen stören würden.

Vernetzte Fertigung: Täglich 22 Tonnen Daten für mehr Qualität

Die Halbleiterfertigung zählt zu den Vorreitern einer vernetzten Produktion. In der Fabrik entstehen künftig Produktionsdaten im Umfang von umgerechnet 500 Textseiten pro Sekunde – an einem Tag entsprächen das mehr als 42 Millionen beschriebene Blatt Papier mit einem Gewicht von 22 Tonnen. Deshalb spielt bei der Herstellung der Chips im künftigen Werk künstliche Intelligenz eine besondere Rolle: Die hochautomatisierten Fertigungsanlagen analysieren ihre Prozessdaten selbst, um ihre Abläufe zu optimieren. Damit erhöht sich die Qualität der Chips bei sinkenden Fertigungskosten. Ebenso können die Planungs- und Prozessingenieure jederzeit auf diese Fertigungsdaten zugreifen, um die Entwicklung neuer Halbleiterprodukte zu beschleunigen oder Toleranzen in der Herstellung frühzeitig zu minimieren. „Für diese vernetzte und automatisierte Produktion suchen wir kreative Köpfe – vor allem Experten in der Halbleitertechnik, wie Prozessingenieure, Mathematiker oder auch Softwareentwickler“, sagte Graf. Viele neue Mitarbeiter seien für Dresden bereits eingestellt und das hohe Bewerberinteresse hielte weiter an.

Führender Halbleiterhersteller mit 45 Jahren Kompetenz

Bosch fertigt Halbleiter-Chips seit mehr als 45 Jahren in verschiedenen Ausführungen, vor allem als anwendungsspezifische Schaltungen (ASIC). In seiner Chipfabrik in Reutlingen produziert Bosch heute ASICs, Leistungshalbleiter und mikroelektromechanische Systeme (MEMS). ASICs von Bosch sind bereits seit 1970 in Fahrzeugen im Einsatz. Sie sind auf eine jeweilige Anwendung zugeschnitten und zum Beispiel wesentlich für die Motorsteuerung oder Auslösung eines Airbags. 2016 hatte jedes weltweit neu ausgelieferte Auto im Schnitt mehr als neun Chips von Bosch an Bord.

Pressebilder: #1361836, #1164163, #1339964, #1100697, #1136646, #534371, #1289914, #1243990, #1373444, #1373445, #1373446

Journalistenkontakte:

Sven Kahn (Grundsteinlegung Halbleiterwerk Dresden)

Telefon: +49 711 811-6415

Twitter: @BoschPresse

Annett Fischer (Automobilelektronik)

Telefon: +49 711 811-6286

Twitter: @Annett__Fischer

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 402 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2017). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 78,1 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in 60 Ländern. Inklusiv Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 64 500 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 125 Standorten.

Das Unternehmen wurde 1886 als „Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik“ von Robert Bosch (1861–1942) in Stuttgart gegründet. Die gesellschaftsrechtliche Struktur der Robert Bosch GmbH sichert die unternehmerische Selbstständigkeit der Bosch-Gruppe. Sie ermöglicht dem Unternehmen langfristig zu planen und in bedeutende Vorleistungen für die Zukunft zu investieren. Die Kapitalanteile der Robert Bosch GmbH liegen zu 92 Prozent bei der gemeinnützigen Robert Bosch Stiftung GmbH. Die Stimmrechte hält mehrheitlich die Robert Bosch Industrietreuhand KG; sie übt die unternehmerische Gesellschafterfunktion aus. Die übrigen Anteile liegen bei der Familie Bosch und der Robert Bosch GmbH.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse.

Grundsteinlegung 300-Millimeter-Halbleiterwerk Dresden

25. Juni 2018
PI 10675 AE Ka/af

Allgemeine Informationen

- ▶ Investitionssumme rund eine Milliarde Euro
- ▶ Grundstück ca. 100 000 m²
(ca. 14 Fußballfelder)
- ▶ Gesamtnutzfläche ca. 72 000 m² Fertigungs-
und Büroflächen
- ▶ Bauverlauf Spatenstich Frühjahr 2018
Maschineninstallation Mitte/Ende 2019
Pilotproduktion ab Ende 2021
- ▶ Mitarbeiter im Endausbau bis zu 700
- ▶ Gesuchte Berufsqualifikationen Experten aus der Halbleiterindustrie,
wie Prozess-, Produktions- oder
Instandhaltungsingenieure,
Mathematiker, Softwareentwickler
sowie Berufserfahrene aus
Studienrichtungen wie Physik, Chemie
und Mikrosystemtechnik
- ▶ Fertigungstechnologie Hochautomatisierte Halbleiterproduktion
(300-mm-Siliziumsubstrate (Wafer)
mit Strukturbreiten bis 65 nm;
1 nm ist ein Millionstel Millimeter)

- ▶ Vernetzte Produktion
Pro Sekunde übertragen die Maschinen ein Gigabit Produktionsdaten. Täglich entstehen Datenmengen, die umgerechnet mehr als 42 Millionen beschriebene Blatt Papier mit einem Gewicht von 22 Tonnen ergäben.

Informationen zum Bauwerk

- ▶ Gesamtbaumasse 600 000 m³
- ▶ Betonbedarf ca. 66 500 m³
(etwa 8 300 LKW-Betonmischer)
- ▶ Stahlbedarf ca. 16 400 Tonnen
(etwa 30 A380-Passagierflugzeuge)
- ▶ Erdbewegungen/-aushub ca. 90 000 m³
(etwa 7 500 Lkw-Ladungen)
- ▶ Bohrfähle für das Fundament ca. 860 Stück
- ▶ Bodenplatte 100 cm Dicke
- ▶ Länge der Rohrleitungen ca. 80 km
- ▶ Länge der Elektroleitungen ca. 380 km
(2 x Strecke Berlin-Dresden)

Internetquellen

- ▶ Stellenbörse für Bewerber www.bosch-career.de/jobs
- ▶ Standortseite Dresden www.bosch.de/unser-unternehmen/bosch-in-deutschland/dresden
- ▶ Halbleiter von Bosch www.bosch-semiconductors.com

Halbleiterfertigung bei Bosch

25. Juni 2018

PI 10676 AE Ka/af

- ▶ **Aktuelles Portfolio**

Anwendungsspezifische Schaltungen (ASICs), Leistungshalbleiter und Massenflusssensoren für Fahrzeugsteuergeräte. Beschleunigungs-, Drehraten- und Drucksensoren für Fahrzeugsteuergeräte und Consumeranwendungen, Umwelt- und Magnetfeldsensoren sowie Projektoren für Consumeranwendungen
- ▶ **Fertigungsstandorte**

Reutlingen (150-mm- und 200-mm-Technologie)
- ▶ **Patente**

Bosch hält mehr als 1 000 Patente und Patentanmeldungen im Bereich der MEMS- und Halbleitertechnologie
- ▶ **Markt**

Bosch fertigt Halbleiter und MEMS-Sensoren für den Eigenbedarf. Große Teile des Portfolios werden auch am freien Markt angeboten.
- ▶ **Historie**

Seit mehr als 45 Jahren entwickelt und fertigt Bosch mikroelektronische Bauteile und Systeme; Bosch hat vor fast 25 Jahren den Halbleiter-Fertigungsprozess für mikroelektromechanische Sensoren (MEMS-Sensoren) entwickelt und ist dort Weltmarktführer.



BOSCH

25. Juni 2018
RF 10679-d Ka/af

Deutschland kann Hightech:

Halbleiter sind der Grundstein für mehr Lebensqualität

Statement von Dr. Dirk Hoheisel,

Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH

anlässlich der Pressekonferenz zur Grundsteinlegung

des 300-Millimeter-Halbleiterwerks Dresden am 25.06.2018

Es gilt das gesprochene Wort.

Robert Bosch GmbH
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart

Corporate Communications
and Brand Management
E-Mail: Sven.Kahn@bosch.com
Telefon: +49 711 811-6415
Twitter: @BoschPresse

Leitung: Dr. Christoph Zemelka
www.bosch-presse.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor nur fast einem Jahr haben wir gemeinsam die Entscheidung zum Bau unserer neuen 300-Millimeter-Halbleiterfabrik bekannt geben – heute können wir nach komplexen Planungsschritten den Grundstein für die Chipfabrik der Zukunft von Bosch legen. Wir legen damit zugleich den Grundstein für mehr Lebensqualität der Menschen, wir legen den Grundstein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr – und wir legen den Grundstein für eine Schlüsseltechnologie des Internets der Dinge sowie der Mobilität der Zukunft.

Halbleiter sind Kernbestandteil aller elektrischen Systeme. Und Halbleiter machen Daten auch zum begehrten Rohstoff der Zukunft – ohne Halbleiter würde heute kein Auto mehr fahren. Sie ermöglichen automatisiertes, ressourcenschonendes Fahren und sorgen für bestmöglichen Insassenschutz – etwa beim Auslösen eines Airbags. Für die immer größeren Anwendungsfelder von Halbleitern erweitern wir unsere Fertigungskapazitäten und setzen für unser neues Werk auf den Technologiestandort Deutschland. Mit dem Neubau steigen wir erstmals in die 300-Millimeter-Technologie ein, um weitere Skaleneffekte zu erzielen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Landeshauptstadt Dresden ist für uns ein Motor der Mikroelektronik in Europa – und war damit weltweit die erste Wahl für unsere Milliardeninvestition. Ich bin überzeugt: Deutschland kann Hightech. Durch eine enge Kooperation mit Halbleiterunternehmen, Wissenschaft und Lehre wollen wir sowohl unsere Innovationskraft als auch die Wettbewerbsfähigkeit dieser Hochtechnologiebranche stärken – in Deutschland und in Europa.

Meine Damen und Herren, in unserer Chipfabrik schaffen wir mit hochautomatisierten Fertigungsprozessen täglich nicht nur Zukunft in Form von Halbleiter. Wir schaffen ebenso die Zukunft für hochattraktive Arbeitsplätze. In unserem Hightech-Werk sollen künftig bis zu 700 Mitarbeiter tätig sein. Wir suchen kreative Köpfe, die den Bau der modernsten Chipfabrik von Bosch mitgestalten. Dazu setzen wir stark auf Fachkräfte aus der Region, aber auch auf internationale Kompetenzträger und Experten.

Unser neues Bauvorhaben ist zugleich die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Bosch. Wir investieren rund eine Milliarde in unseren neuen Standort und freuen uns, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beabsichtigt, die Einrichtung und Inbetriebnahme zu unterstützen. Neben der Bundesregierung haben auch das Land Sachsen und die Stadt Dresden Unterstützung zugesichert. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Bundesminister Altmaier, und auch bei Ihnen, Herr Ministerpräsident Kretschmer. Sie und Ihre Vorgänger haben dazu beigetragen, dass wir heute gemeinsam bereits den symbolischen Grundstein legen können – für mehr Lebensqualität der Menschen, für die Halbleiterbranche in Dresden und für die Wettbewerbsfähigkeit des Technologiestandortes Deutschland.



19. Juli 2016

RB Na

Dr.-Ing. Dirk Hoheisel

Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH

Dr.-Ing. Dirk Hoheisel ist seit Juli 2012 Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. In dieser Funktion verantwortet er die Systemintegration des Unternehmensbereichs Mobility Solutions sowie die Geschäftsbereiche Chassis Systems Control, Car Multimedia, Automotive Electronics, Automotive Steering und den Produktbereich Two Wheeler & Powersports.

Dirk Hoheisel wurde 1958 in Hameln geboren, er ist verheiratet und hat ein Kind. Er studierte Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin, wo er auch auf dem Gebiet der Halbleitertechnik promovierte.

Stationen in der Bosch-Gruppe

- | | |
|------------------|---|
| 1990 | Fachreferent Geschäftsbereich Halbleiter und elektronische Steuergeräte, Reutlingen |
| 1994 | Abteilungsleiter Geschäftsbereich Halbleiter und elektronische Steuergeräte, Reutlingen |
| 1998 | Abteilungsleiter Geschäftsbereich Mobile Kommunikation, Hildesheim |
| 2000 | Technischer Leiter Geschäftsbereich Car Multimedia, Produktbereich Anzeigesysteme, Leonberg |
| 2002 | Produktbereichsleiter Geschäftsbereich Car Multimedia, Produktbereich Fahrerinformationssysteme, Hildesheim |
| 2004 | Mitglied Bereichsvorstand Geschäftsbereich Car Multimedia, Hildesheim |
| 2011 | Mitglied Bereichsvorstand Chassis Systems Control, Abstatt |
| Juli 2012 | Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH |



Standort mit bis zu 700 Arbeitsplätzen **Bosch beginnt mit Bau seiner neuen Halbleiterfabrik**

24. April 2018
PI 10634 AE/MBC

- ▶ Investition in die Zukunftsmärkte Internet der Dinge und autonomes Fahren
- ▶ Dresden bietet ideale Standortbedingungen
- ▶ Modernes Arbeitsumfeld in der Halbleiterfabrik
- ▶ Bosch-Bereichsvorstand Fabrowsky: „Halbleiter sind Zukunft.“

Reutlingen / Dresden, 24. April 2018 – Bosch beginnt mit dem Bau seines Halbleiterwerks in Dresden: Auf einem rund 100 000 m² großen Grundstück in der Nähe des Flughafens entsteht eine der modernsten Chipfabriken der Welt. Jens Fabrowsky, Mitglied des Bereichsvorstands des Geschäftsbereichs Automotive Electronics bei Bosch, vollzog den symbolischen Spatenstich zusammen mit Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Stadt Dresden, im Beisein vieler Vertreter aus Wirtschaft und Politik. „Halbleiter sind eine Schlüsseltechnologie für die vernetzte Welt“, erklärt Fabrowsky zum Baustart. „Kein Auto könnte heute ohne Halbleiter mehr fahren.“ Am neuen Standort sollen für die wachsenden Anwendungen in der Mobilität und im Internet der Dinge Halbleiter auf Basis von 300 Millimeter Technologien produziert werden. Der Bau des Hightech-Werks soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein, die Anlaufphase beginnt voraussichtlich Ende 2021.

Vernetzung: hoher Bedarf an Halbleitern

Halbleiter sind die Kernkomponenten aller elektronischen Systeme. Ihre Anwendungsfelder werden durch die zunehmende Vernetzung und Automatisierung immer größer. Laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers legt der globale Halbleitermarkt allein bis 2019 jährlich um mehr als fünf Prozent zu. Besonders stark wachsen die Marktsegmente Mobilität und Internet der Dinge (IoT). Mit der Erweiterung der Fertigungskapazitäten für Halbleiter stellt sich Bosch für die Zukunft auf und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit.

Mit über einer Milliarde Euro ist der Bau der Halbleiterfabrik die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Die in Dresden künftig hergestellten Chips sind unter anderem für den Einsatz im IoT und für das automatisierte Fahren zugeschnitten.

Dresden: Optimale Voraussetzungen für Bosch

„Der Standort Dresden bietet uns sehr gute Voraussetzungen“, erklärt Fabrowsky. „Die sächsische Landeshauptstadt ist bekannt für ihr in Europa einmaliges Mikroelektronik-Cluster.“ Dies umfasst Unternehmen der Zulieferer-, Dienstleister- und Anwenderindustrie sowie Universitäten mit entsprechender technologischer Expertise. Auch soll in Dresden mit der „Digital Hub Initiative“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ein Ökosystem für das Internet der Dinge entwickelt werden. Dazu will auch Bosch beitragen. Fabrowsky weiter: „Wir wollen eng mit den lokal ansässigen Halbleiterfirmen und Universitäten kooperieren, um einerseits unser Unternehmen nach vorne zu bringen. Andererseits wollen wir den Standort Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb stärken.“

Moderne Arbeitsplätze: bis zu 700 Mitarbeiter

Die neue Fabrik wird hochautomatisiert produzieren und damit zeigen, wie heute in höchster Qualität über die komplette Vernetzung der Produktionsdaten optimal geplant, effizient gefertigt und zuverlässig geliefert werden kann. „Das neue Werk wird aber nicht nur technisch, sondern auch bei der Arbeitsplatzgestaltung Maßstäbe setzen,“ sagt Otto Graf, zukünftiger Leiter des neuen Bosch-Werks in Dresden. „Unsere künftigen Mitarbeiter erwartet ein außergewöhnlich motivierendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit viel Raum, Licht und modernster Ausstattung.“ Eine zentrale Rolle spielt bei Bosch auch die flexible und familienbewusste Arbeitskultur. Das Unternehmen unterstützt zum Beispiel mehr als 100 Arbeitszeitmodelle und erkennt privates wie berufliches Engagement gleichermaßen an.

Sensoren und Halbleiter heute

Halbleiter sind – trotz ihrer langen Geschichte – vor allem Zukunft. Sie sind technischer Baustein der zukünftigen Mobilität und dem IoT und kommen auch in den mikroelektromechanischen Sensoren von Bosch zum Einsatz, mit denen für das Vernetzungsgeschäft Daten in Geräten und Maschinen erfasst werden. Mit Software werden diese Daten ausgewertet und die Sensoren und Geräte an das Internet angebunden. Aus den Informationen entwickelt Bosch schließlich Services, die das Leben der Menschen einfacher und komfortabler machen. Wie kaum ein zweites Unternehmen beherrscht Bosch somit die gesamte Wertschöpfungskette der Vernetzung – sowohl auf der Hardware- als auch auf der Softwareebene.

Pressebilder: #1136646, #1136600, #1136620, #534372, #534374

Journalistenkontakt:

Joachim Kornmayer,

Telefon: +49 7121-35-30418

joachim.kornmayer@bosch.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 400 500 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2017). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 78 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 62 500 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 125 Standorten.

Das Unternehmen wurde 1886 als „Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik“ von Robert Bosch (1861–1942) in Stuttgart gegründet. Die gesellschaftsrechtliche Struktur der Robert Bosch GmbH sichert die unternehmerische Selbstständigkeit der Bosch-Gruppe. Sie ermöglicht dem Unternehmen langfristig zu planen und in bedeutende Vorleistungen für die Zukunft zu investieren. Die Kapitalanteile der Robert Bosch GmbH liegen zu 92 Prozent bei der gemeinnützigen Robert Bosch Stiftung GmbH. Die Stimmrechte hält mehrheitlich die Robert Bosch Industrietreuhand KG; sie übt die unternehmerische Gesellschafterfunktion aus. Die übrigen Anteile liegen bei der Familie Bosch und der Robert Bosch GmbH.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-semiconductors.com, www.bosch-mobility-solutions.com, iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, twitter.com/BoschPresse.



Schlüsseltechnologie für das Internet der Dinge: Bosch errichtet neues Halbleiterwerk in Dresden Milliardeninvestition in 300-Millimeter-Technologie

19. Juni 2017

PI 9477 RB joe/KB

- ▶ Investition in neuen Fertigungsstandort mit bis zu 700 Mitarbeitern beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro.
- ▶ Bosch-Chef Denner: „Die neue Fertigung für Halbleiter ist die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Geschichte von Bosch.“
- ▶ Bosch-Geschäftsführer Dirk Hoheisel: „Für den Ausbau unserer Halbleiterkompetenz bietet der Wirtschaftsstandort Sachsen gute Voraussetzungen.“
- ▶ Bundes- und Landespolitik begrüßen Bosch-Engagement in Deutschland.

Stuttgart/Dresden – Bosch investiert weiter kräftig in Deutschland und errichtet eine Chipfabrik in Dresden. Am neuen Standort sollen für die wachsenden Anwendungen in der Mobilität und im Internet der Dinge Halbleiter auf Basis der 300-Millimeter-Technologie produziert werden. Der Bau des Hightech-Werks soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Die Produktion wird nach einer Anlaufphase voraussichtlich Ende 2021 beginnen. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen für den Standort auf rund eine Milliarde Euro. „Die neue Fertigung für Halbleiter ist die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Geschichte von Bosch“, sagte Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. In Dresden sollen bis zu 700 neue Arbeitsplätze entstehen. „Halbleiter sind die Kernkomponenten aller elektronischen Systeme. Ihre Anwendungsfelder werden durch die zunehmende Vernetzung und Automatisierung immer größer. Mit der Erweiterung unserer Fertigungskapazitäten für Halbleiter stellen wir uns für die Zukunft auf und stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Denner. Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers legt der globale Halbleitermarkt allein bis 2019 jährlich um mehr als fünf Prozent zu. Besonders stark wachsen die Marktsegmente Mobilität und Internet der Dinge.

Investition in den Hochtechnologiestandort Deutschland

Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie (BMWi), würdigt die Investition von Bosch in den Hochtechnologiestandort Deutschland: „Wir begrüßen die Investitionsentscheidung von Bosch in Sachsen. Die Stärkung der Halbleiterkompetenz in Deutschland und damit auch in Europa ist eine Investition in eine zentrale Zukunftstechnologie und damit ein ganz wichtiger Schritt für den Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit auch des Industriestandorts Deutschland.“ Das BMWi beabsichtigt – vorbehaltlich der Genehmigung der Europäischen Kommission – die Einrichtung und Inbetriebnahme der neuen Halbleiter-Fertigung in Dresden zu unterstützen. „Für den Ausbau unserer Halbleiterkompetenz bietet der Wirtschaftsstandort Sachsen gute Voraussetzungen“, sagte Dr. Dirk Hoheisel, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Dresden ist bekannt für sein in Europa einmaliges Mikroelektronik-Cluster, genannt „Silicon Saxony“. Das Cluster umfasst Unternehmen der Zulieferer-, Dienstleister- und Anwenderindustrie sowie Universitäten mit entsprechender technologischer Expertise. Zudem soll Dresden mit der „Digital Hub Initiative“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zu einem Ökosystem für das Internet der Dinge entwickelt werden. Bosch beabsichtigt, eng mit den lokal ansässigen Halbleiterfirmen zu kooperieren und so nicht nur den Standort Deutschland, sondern Europa insgesamt im internationalen Vergleich zu stärken. „Das ist die nächste gute Entscheidung für Europas führendes Mikroelektronik-Cluster hier bei uns in Sachsen. Ich danke Bosch für das Vertrauen in den Standort, seine Mitarbeiter und die sächsische Innovationskraft. Neuartige Produkte für das Internet der Dinge und Industrie 4.0 sind mit die wichtigsten Themen in der Mikroelektronikbranche und der europäischen Industrie“, sagte Stanislaw Tillich, Ministerpräsident von Sachsen.

Mit 300-Millimeter-Technologie Skaleneffekte erreichen

Halbleiter sind eine Schlüsseltechnologie für das moderne Leben, besonders bei der wachsenden Vernetzung, Elektrifizierung und Automatisierung in der Industrie, in der Mobilität und im Smart Home. Basis für die Fertigung von Halbleiter-Chips aller Art ist eine Wafer genannte Siliziumscheibe. Je größer ihr Durchmesser, desto mehr Chips können pro Fertigungsdurchgang hergestellt werden. Mit der 300-Millimeter-Technologie lassen sich im Vergleich zur etablierten Fertigung mit kleineren 150- und 200-Millimeter-Wafern Skaleneffekte erzielen. Diese sind wichtig, damit Bosch die Nachfrage nach Halbleitern bedienen kann, die zum Beispiel durch die vernetzte Mobilität sowie durch Anwendungen im Bereich Smart Home und Smart City stetig steigt.

Führender Halbleiter-Hersteller und Pionier der MEMS-Fertigung

Bosch fertigt Halbleiter-Chips seit mehr als 45 Jahren in verschiedenen Ausführungen, vor allem als anwendungsspezifische Schaltungen (ASIC), Leistungshalbleiter und mikroelektromechanische Systeme (MEMS). ASICs von Bosch kommen bereits seit 1970 in Fahrzeugen zum Einsatz. Sie sind auf eine jeweilige Anwendung zugeschnitten und zum Beispiel wesentlich für die Auslösung eines Airbags. 2016 hatte jedes neu ausgelieferte Auto weltweit im Schnitt mehr als neun Chips von Bosch an Bord.

Pionier und weltweit führender Hersteller ist Bosch im Bereich der MEMS-Sensoren. Den zugrunde liegenden Halbleiter-Fertigungsprozess hat das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen vor mehr als 20 Jahren selbst entwickelt. In seiner Chipfabrik in Reutlingen fertigt Bosch heute täglich rund 1,5 Millionen ASICs sowie vier Millionen MEMS-Sensoren auf Basis der 150- und 200-Millimeter-Technologie. Insgesamt hat das Unternehmen seit 1995 bereits mehr als acht Milliarden MEMS-Sensoren produziert. Mittlerweile finden 75 Prozent der MEMS-Sensoren von Bosch in der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik Verwendung. In drei von vier Smartphones stecken MEMS-Sensoren von Bosch. Das aktuelle Halbleiter-Portfolio umfasst vor allem Beschleunigungs-, Drehraten-, Massenfluss-, Druck- und Umweltsensoren sowie Mikrofone, Leistungshalbleiter und ASICs für Fahrzeugsteuergeräte.

Pressebilder: #534371, #534372, #534374, #534393, #535387, #1100697, #1100702

Weiterführende Links: www.semiconductors.com, www.bosch-connectivity.com

Journalistenkontakt: Jörn Ebberg, Telefon: +49 711 811-26223

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 390 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2016). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regional-gesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 59 000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 120 Standorten.

Das Unternehmen wurde 1886 als „Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik“ von Robert Bosch (1861–1942) in Stuttgart gegründet. Die gesellschaftsrechtliche Struktur der Robert Bosch GmbH sichert die unternehmerische Selbstständigkeit der Bosch-Gruppe. Sie ermöglicht dem Unternehmen langfristig zu planen und in bedeutende Vorleistungen für die Zukunft zu investieren. Die Kapitalanteile der Robert Bosch GmbH liegen zu 92 Prozent bei der gemeinnützigen Robert Bosch Stiftung GmbH. Die Stimmrechte hält mehrheitlich die Robert Bosch Industrietreuhand KG; sie übt die unternehmerische Gesellschafterfunktion aus. Die übrigen Anteile liegen bei der Familie Bosch und der Robert Bosch GmbH.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse.



BOSCH

19. Juni 2017
joe

**Schlüsseltechnologie für die Automobiltechnik und das
Internet der Dinge: Bosch errichtet neues Halbleiterwerk
in Dresden**

Statement von Dr. Dirk Hoheisel,
Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH
anlässlich des Pressegesprächs am 19. Juni 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

Robert Bosch GmbH
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart

Corporate Communications,
Brand Management,
and Sustainability
E-Mail
joern.ebberg@bosch.com
Telefon: +49 711 811-26223
Telefax: +49 711 811-5187718

Leitung: Dr. Christoph Zemelka
www.bosch-presse.de

Vielen Dank, Herr Staatssekretär Machnig, für die Einführung und Einordnung. Meine Damen und Herren, auch ich freue mich, Sie zu unserem Pressgespräch begrüßen zu können. Noch mehr freue ich mich, hier und heute die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Geschichte von Bosch anzukündigen: Wir haben uns entschlossen, in Dresden eine neue Halbleiterfertigung zu errichten. Ab 2021 sollen dort Halbleiter auf Basis der 300-Millimeter-Technologie produziert werden. Das Investitionsvolumen dafür beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro. Bis zu 700 neue Hightech-Arbeitsplätze werden entstehen. Mit dem Bau der Chipfabrik und der Investition in die Zukunftstechnologie bekennen wir uns einmal mehr zum Technologie- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Deutschland kann Hightech. Auch in Deutschland lohnen sich weiterhin Milliardeninvestitionen in anspruchsvolle Zukunftstechnologien. Mit der neuen Halbleiterfertigung erweitern wir unsere Fertigungskapazitäten für Halbleiter und stärken für die Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft nicht nur von Bosch, sondern auch von Deutschland. Ich bin überzeugt, diese Fabrik ist für Bosch eine wichtige und richtige, für den Standort Deutschland eine gute Entscheidung.

Die moderne Technikwelt fußt auf Halbleitern. Sie sind die Kernkomponente aller elektronischen Systeme. Ohne Halbleiter sähe unser Alltag heute ganz anders aus: Es gäbe keine Computer, keine Smartphones, keine Tablets – einfach keine modernen Elektronikgeräte. Nicht zu vergessen: Ohne Halbleiter fährt heute und auch in Zukunft kein Auto mehr. Der Verkehr der Zukunft wird automatisiert, elektrifiziert und vernetzt sein. Alles undenkbar ohne Halbleiter. Und ein gerade für Deutschland wichtiger Trend wird durch die Halbleiter-Technologie erst ermöglicht: Es ist die Vernetzung über das Internet der Dinge. Ob Industrie 4.0, das Smart Home oder die Smart City – nur mit Halbleitern können wir unsere Lebens- und Arbeitswelten vernetzen und so zu mehr Sicherheit, mehr Ressourcenschutz, mehr Komfort und mehr Lebensqualität für Menschen beitragen. Das damit verbundene Geschäftspotenzial ist riesig. Laut einer externen Studie legt der globale Halbleitermarkt allein bis 2019 jährlich um mehr als fünf Prozent zu (Quelle: PricewaterhouseCoopers) – dies bietet auch enorme Chancen für Bosch.

Emissionsfrei, stressfrei und unfallfrei – so soll nach unserer Vision die Mobilität der Zukunft sein. Als weltweit größter und technologisch führender Automobilzulieferer arbeiten wir an den Zielen null Unfälle, null Emissionen und null Stress. Bereits heute haben wir in der Automobilindustrie ein Alleinstellungsmerkmal: In fast jedem Auto weltweit sind Bosch-Systeme verbaut. Und nahezu alle Bosch-Systeme wie zum Beispiel der Lebensretter ESP im Fahrzeug enthalten Halbleiter. 2016 hatte jedes neu ausgelieferte Auto weltweit im Schnitt mehr als neun Chips von Bosch an Bord. Bosch verfügt über eine mehr als 45-jährige Tradition in der Halbleiter-Fertigung und damit auch über 45 Jahre Technikkompetenz sowie Fertigungs- und Entwicklungs-Know-how.

Meine Damen und Herren, strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Halbleiter sind – trotz ihrer langen Geschichte – vor allem Zukunft. Sie sind technischer Baustein des Internets der Dinge. Sie kommen in unseren mikroelektromechanischen Sensoren zum Einsatz, mit denen wir für das Vernetzungsgeschäft Daten in Geräten und Maschinen erfassen. Mit Software werten wir diese Daten aus und binden die Sensoren und Geräte an das Internet an. Aus den Informationen entwickeln wir schließlich Services, die Menschen das Leben einfacher und komfortabler machen. Wie kaum ein zweites Unternehmen beherrschen wir somit die gesamte Wertschöpfungskette der Vernetzung – sowohl auf der Hardware – als auch auf der Softwareebene.

Beides – Mobilität und Vernetzung führen zu einem steigenden Bedarf nach Halbleitern. Der neue Fertigungsstandort hilft uns, die steigende Nachfrage auch in Zukunft zuverlässig bedienen zu können. Der Bau des Hightech-Werks soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Die Produktion beginnt nach einer Anlaufphase voraussichtlich Ende 2021. Es freut uns, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beabsichtigt – vorbehaltlich der Genehmigung der Europäischen Kommission –, die Einrichtung und Inbetriebnahme der neuen Halbleiter-Fertigung in Dresden zu unterstützen. Neben der Bundesregierung haben auch das Land Sachsen und die Stadt Dresden zugesichert, diese und künftige Aktivitäten von Bosch zu fördern. Dafür

danke ich Ihnen herzlich lieber Herr Staatssekretär, und Ihnen lieber Herr Ministerpräsident. Sie haben mit Ihrer persönlichen Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute hier stehen.

Der Standort Dresden bietet uns sehr gute Voraussetzungen. Die sächsische Landeshauptstadt ist bekannt für ihr in Europa einmaliges Mikroelektronik-Cluster, genannt „Silicon Saxony“. Das Cluster umfasst Unternehmen der Zulieferer-, Dienstleister- und Anwenderindustrie sowie Universitäten mit entsprechender technologischer Expertise. Auch soll in Dresden mit der „Digital Hub Initiative“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ein Ökosystem für das Internet der Dinge entwickelt werden. Dazu wollen wir beitragen: Wir wollen eng mit den lokal ansässigen Halbleiterfirmen und Universitäten kooperieren, um unser Unternehmen nach vorne zu bringen und gleichzeitig wollen wir den Standort Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb stärken. Denn wir sind – gemeinsam mit der Politik – der Ansicht, dass sowohl Deutschland als auch Europa in dieser Schlüsselindustrie weiter engagiert bleiben müssen. Nicht ohne Grund stehen künftig beide Bosch-Halbleiterfertigungen in Deutschland; eine heute im baden-württembergischen Reutlingen. Die zweite bald in Dresden.

Meine Damen und Herren, der Neubau unserer Halbleiterfertigung ist eine gute Nachricht für Bosch, für die Stadt Dresden, das Land Sachsen und auch für den Innovations- und Hightech-Standort Deutschland.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Journalistenkontakt:

Jörn Ebberg,

Telefon +49 711 811-26223